



平成30年3月期 第1四半期決算短信(日本基準)(連結)

平成29年8月7日

上場会社名 住友ベークライト株式会社

上場取引所 東

コード番号 4203 URL <http://www.sumibe.co.jp>

代表者 (役職名) 代表取締役社長 (氏名) 林 茂

問合せ先責任者 (役職名) 総務本部 コーポレート・コミュニケーション部長 (氏名) 吉田 英司

TEL 03-5462-4111

四半期報告書提出予定日 平成29年8月9日

配当支払開始予定日

四半期決算補足説明資料作成の有無 : 有

四半期決算説明会開催の有無 : 有 (証券アナリスト、機関投資家向け)

(百万円未満切捨て)

1. 平成30年3月期第1四半期の連結業績(平成29年4月1日～平成29年6月30日)

(1) 連結経営成績(累計)

(%表示は、対前年同四半期増減率)

	売上高		営業利益		経常利益		親会社株主に帰属する四半期純利益	
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%
30年3月期第1四半期	52,509	6.8	4,954	33.5	5,165	32.8	3,724	36.5
29年3月期第1四半期	49,185	7.2	3,711	38.2	3,890	37.2	2,728	66.0

(注) 包括利益 30年3月期第1四半期 6,113百万円 (%) 29年3月期第1四半期 8,474百万円 (%)

	1株当たり四半期純利益	潜在株式調整後1株当たり四半期純利益
	円 銭	円 銭
30年3月期第1四半期	15.83	
29年3月期第1四半期	11.59	

(2) 連結財政状態

	総資産	純資産	自己資本比率
	百万円	百万円	%
30年3月期第1四半期	269,304	171,921	63.2
29年3月期	263,742	167,167	62.7

(参考) 自己資本 30年3月期第1四半期 170,223百万円 29年3月期 165,353百万円

2. 配当の状況

	年間配当金				
	第1四半期末	第2四半期末	第3四半期末	期末	合計
	円 銭	円 銭	円 銭	円 銭	円 銭
29年3月期		5.00		5.00	10.00
30年3月期					
30年3月期(予想)		6.00		6.00	12.00

(注) 直近に公表されている配当予想からの修正の有無 : 無

3. 平成30年3月期の連結業績予想(平成29年4月1日～平成30年3月31日)

(%表示は、通期は対前期、四半期は対前年同四半期増減率)

	売上高		営業利益		経常利益		親会社株主に帰属する当期純利益		1株当たり当期純利益
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%	円 銭
第2四半期(累計)	103,000	5.8	8,100	11.3	8,300	10.7	5,500	4.8	23.37
通期	210,000	6.0	18,000	6.6	18,400	6.2	11,500	8.3	48.87

(注) 直近に公表されている業績予想からの修正の有無 : 無

注記事項

- (1) 当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動(連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動) : 無
- (2) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 : 無
- (3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示
- | | |
|--------------------|-----|
| 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更 | : 無 |
| 以外の会計方針の変更 | : 無 |
| 会計上の見積りの変更 | : 無 |
| 修正再表示 | : 無 |

(4) 発行済株式数(普通株式)

期末発行済株式数(自己株式を含む)	30年3月期1Q	247,952,394 株	29年3月期	247,952,394 株
期末自己株式数	30年3月期1Q	12,618,510 株	29年3月期	12,615,524 株
期中平均株式数(四半期累計)	30年3月期1Q	235,336,013 株	29年3月期1Q	235,351,420 株

四半期決算短信は四半期レビューの対象外です

業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報および合理的であると判断する一定の前提に基づいており、その達成を当社として約束する趣旨のものではありません。また、実際の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。

○添付資料の目次

1. 当四半期決算に対する定性的情報	2
(1) 経営成績に関する説明	2
(2) 財政状態に関する説明	3
(3) 連結業績予想などの将来予測情報に関する説明	3
2. 四半期連結財務諸表及び主な注記	4
(1) 四半期連結貸借対照表	4
(2) 四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書	6
(3) 四半期連結財務諸表に関する注記事項	8
(継続企業の前提に関する注記)	8
(株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記)	8
(セグメント情報等)	9

1. 当四半期決算に関する定性的情報

(1) 経営成績に関する説明

当第1四半期連結累計期間の世界経済は、米国は景気回復が継続し、欧州でも欧州中央銀行の金融緩和政策などにより、景気の緩やかな回復基調が続きました。また中国では、当局によるインフラ関連投資等による下支え政策により、景気減速に歯止めがかかりつつあります。日本経済においても雇用情勢の改善が持続し、株価上昇も受け消費者マインドも改善してきました。

当社グループを取り巻く経営環境は、半導体においては、スマートフォンやサーバ、ストレージ機器向けの需要に加え、車載向けの需要が増加し、市場は好調でした。自動車においては、米国では新車販売がやや低調でしたが、南欧を中心とした欧州や、商用車の販売台数増加があった中国では堅調でした。国内では普通車の新車投入効果などで出荷台数が増加しました。国内の住宅着工件数は横ばいでした。

当社グループはこのような経営環境の中、「CS（顧客満足）最優先」のもと、顧客との関係を深め、社内外の連携・協業の強化、コスト構造改革による事業体質転換を推進しております。さらに次の基本戦略を掲げ、中長期的な企業価値の向上に向けて取り組んでまいりました。

- ①新製品の早期立ち上げ、創生
- ②成長分野の収益力強化、規模拡大
- ③既存事業の再生、事業転換

この結果、当第1四半期連結累計期間の連結売上高は、主に販売数量が増加した影響により、525億9百万円と、前年同期比で6.8%、33億24百万円の増収となりました。損益につきましては、連結営業利益は、原料価格の上昇があったものの、各セグメントでの販売数量の増加による好転に加え、固定費削減効果も寄与し、前年同期比で33.5%増の49億54百万円となり、連結経常利益も、前年同期比で32.8%増の51億65百万円となりました。親会社株主に帰属する四半期純利益は、前年同期比で36.5%増の37億24百万円となりました。

セグメント別販売状況（対前年同期比較）

①半導体関連材料

半導体封止用エポキシ樹脂成形材料は、販売数量が伸長し、売上高が増加しました。車載向けを筆頭に、民生用向け産業用向けと各用途で需要が好調でした。

半導体パッケージ基板材料の「LαZ®」は、売上高が減少しましたが、アプリケーションプロセッサやメモリー向けの新たな用途に出荷が始まっています。

②高機能プラスチック

フェノール樹脂成形材料、工業用フェノール樹脂は、アジア地区の電子部品向けや欧州の自動車向けを中心に数量が伸び、さらに原料高に伴う売価是正が寄与し、売上高は増加しました。

航空機内装部品は、顧客の在庫調整により売上高が減少しました。自動車等成形品では、中国生産拠点の上海への集中によるコスト改善を進めておりますが、売上高は減少しました。

銅張積層板は、車載用途が好調で、売上高が増加しました。

③クオリティオブライフ関連製品

医療機器製品は、既存製品での需要回復に加え、血管内治療用デバイス「ステアリングマイクロカテーテル」を始めとする新製品の販売が寄与し、売上高が増加しました。

ビニル樹脂シートおよび複合シートでは、医薬品包装向けが顧客の在庫調整で減少しましたが、カバーテープ・ダイシングフィルム・リリースフィルムなどの産業用途が好調で、売上高は増加しました。鮮度保持フィルム「P-プラス®」は、カット野菜用途や産地野菜用途で採用アイテムが増え、売上高は増加しました。

ポリカーボネート樹脂板、塩化ビニル樹脂板のプレート製品は、建装材用途が好調で、サンレンズ用偏光板が増加しましたが、サイン・ディスプレイ用途が減少し、売上高は横ばいでした。またデコラ製品は、鉄道車両用内装材や不燃メラミン化粧シート「デコライノベア®」などの高機能・高付加価値分野に特化し、売上高は増加しました。

防水関連製品は、新築住宅向けが増加しましたが、リフォーム向けが減少し、売上高は横ばいでした。

(2) 財政状態に関する説明

①資産の部

総資産は、前連結会計年度末に比べ55億62百万円増加し、2,693億4百万円となりました。

これは主に、受取手形及び売掛金が19億75百万円、現金及び預金が15億84百万円、および投資有価証券が15億55百万円増加したことによるものであります。

②負債の部

負債合計は、前連結会計年度末に比べ8億8百万円増加し、973億82百万円となりました。

これは主に、コマーシャル・ペーパーが10億円、その他の流動負債が12億63百万円増加した一方で、賞与引当金が15億37百万円減少したことによるものであります。

③純資産の部

純資産合計は、前連結会計年度末に比べ47億54百万円増加し、1,719億21百万円となりました。

これは主に、親会社株主に帰属する四半期純利益を37億24百万円計上したことに加え、為替換算調整勘定が12億27百万円、その他有価証券評価差額金が11億9百万円増加した一方で、配当金の支払11億76百万円があったことによるものであります。

(3) 連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

平成29年5月15日に公表いたしました業績予想の見直しは行っておりません。

2. 四半期連結財務諸表及び主な注記

(1) 四半期連結貸借対照表

(単位：百万円)

	前連結会計年度 (平成29年3月31日)	当第1四半期連結会計期間 (平成29年6月30日)
資産の部		
流動資産		
現金及び預金	49,733	51,317
受取手形及び売掛金	42,450	44,425
商品及び製品	11,996	11,972
半製品	4,145	3,862
仕掛品	1,296	1,668
原材料及び貯蔵品	11,737	11,621
その他	7,138	7,089
貸倒引当金	△55	△58
流動資産合計	128,442	131,900
固定資産		
有形固定資産		
建物及び構築物（純額）	31,113	31,126
機械装置及び運搬具（純額）	37,596	37,614
その他（純額）	16,776	17,559
有形固定資産合計	85,486	86,300
無形固定資産		
のれん	23,089	22,721
その他	1,647	1,647
無形固定資産合計	24,737	24,369
投資その他の資産	25,075	26,734
固定資産合計	135,299	137,404
資産合計	263,742	269,304

(単位：百万円)

	前連結会計年度 (平成29年3月31日)	当第1四半期連結会計期間 (平成29年6月30日)
負債の部		
流動負債		
支払手形及び買掛金	28,258	28,038
短期借入金	5,115	5,108
1年内返済予定の長期借入金	3,480	3,480
コマーシャル・ペーパー	1,000	2,000
未払法人税等	2,549	2,133
賞与引当金	2,747	1,210
その他の引当金	162	73
その他	10,705	11,968
流動負債合計	54,019	54,013
固定負債		
長期借入金	33,537	33,538
退職給付に係る負債	2,855	2,834
その他の引当金	194	194
その他	5,967	6,802
固定負債合計	42,554	43,369
負債合計	96,574	97,382
純資産の部		
株主資本		
資本金	37,143	37,143
資本剰余金	35,358	35,358
利益剰余金	88,801	91,349
自己株式	△6,741	△6,744
株主資本合計	154,561	157,106
その他の包括利益累計額		
その他有価証券評価差額金	7,451	8,560
為替換算調整勘定	3,879	5,106
退職給付に係る調整累計額	△538	△550
その他の包括利益累計額合計	10,792	13,117
非支配株主持分	1,813	1,697
純資産合計	167,167	171,921
負債純資産合計	263,742	269,304

(2) 四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書

四半期連結損益計算書

第1四半期連結累計期間

(単位：百万円)

	前第1四半期連結累計期間 (自平成28年4月1日 至平成28年6月30日)	当第1四半期連結累計期間 (自平成29年4月1日 至平成29年6月30日)
売上高	49,185	52,509
売上原価	33,526	35,924
売上総利益	15,659	16,584
販売費及び一般管理費	11,948	11,630
営業利益	3,711	4,954
営業外収益		
受取利息	46	79
受取配当金	204	231
持分法による投資利益	70	10
為替差益	—	10
雑収入	63	53
営業外収益合計	385	384
営業外費用		
支払利息	59	65
為替差損	55	—
雑損失	91	107
営業外費用合計	206	173
経常利益	3,890	5,165
特別利益		
固定資産売却益	0	32
投資有価証券売却益	1	—
特別利益合計	2	32
特別損失		
固定資産除売却損	52	64
投資有価証券評価損	10	—
その他	—	11
特別損失合計	63	75
税金等調整前四半期純利益	3,829	5,121
法人税、住民税及び事業税	702	658
法人税等調整額	316	668
法人税等合計	1,018	1,327
四半期純利益	2,810	3,793
非支配株主に帰属する四半期純利益	82	69
親会社株主に帰属する四半期純利益	2,728	3,724

四半期連結包括利益計算書

第1四半期連結累計期間

(単位：百万円)

	前第1四半期連結累計期間 (自平成28年4月1日 至平成28年6月30日)	当第1四半期連結累計期間 (自平成29年4月1日 至平成29年6月30日)
四半期純利益	2,810	3,793
その他の包括利益		
その他有価証券評価差額金	△488	1,108
為替換算調整勘定	△10,847	1,236
退職給付に係る調整額	64	0
持分法適用会社に対する持分相当額	△13	△27
その他の包括利益合計	△11,284	2,319
四半期包括利益	△8,474	6,113
(内訳)		
親会社株主に係る四半期包括利益	△8,409	6,049
非支配株主に係る四半期包括利益	△65	63

(3) 四半期連結財務諸表に関する注記事項

(継続企業の前提に関する注記)

該当事項はありません。

(株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記)

該当事項はありません。

(セグメント情報等)

I 前第1四半期連結累計期間(自平成28年4月1日至平成28年6月30日)

1. 報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

(単位:百万円)

	報告セグメント				その他 (注) 1	合計	調整額 (注) 2	四半期連 結損益計 算書計上 額 (注) 3
	半導体 関連材料	高機能 プラス チック	クオリテ イオブラ イフ関連 製品	計				
売上高								
外部顧客への売上高	11,554	21,777	15,674	49,006	179	49,185	—	49,185
セグメント間の内部 売上高又は振替高	—	33	0	33	—	33	△33	—
計	11,554	21,810	15,674	49,039	179	49,219	△33	49,185
セグメント利益	1,846	1,776	756	4,380	50	4,431	△719	3,711

(注) 1 「その他」の区分は報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、試験研究の受託、土地の賃貸等を含んでおります。

2 「セグメント利益」の調整額△719百万円には、セグメント間取引消去0百万円、各報告セグメントに配分していない全社費用△719百万円が含まれております。全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない基礎研究費用等であります。

3 「セグメント利益」は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。

II 当第1四半期連結累計期間(自平成29年4月1日至平成29年6月30日)

1. 報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

(単位:百万円)

	報告セグメント				その他 (注) 1	合計	調整額 (注) 2	四半期連 結損益計 算書計上 額 (注) 3
	半導体 関連材料	高機能 プラス チック	クオリテ イオブラ イフ関連 製品	計				
売上高								
外部顧客への売上高	12,707	23,089	16,553	52,350	159	52,509	—	52,509
セグメント間の内部 売上高又は振替高	—	40	0	40	—	40	△40	—
計	12,707	23,129	16,553	52,391	159	52,550	△40	52,509
セグメント利益	2,302	1,943	1,371	5,617	51	5,668	△714	4,954

(注) 1 「その他」の区分は報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、試験研究の受託、土地の賃貸等を含んでおります。

2 「セグメント利益」の調整額△714百万円には、セグメント間取引消去6百万円、各報告セグメントに配分していない全社費用△721百万円が含まれております。全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない基礎研究費用等であります。

3 「セグメント利益」は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。

各報告セグメントの主要な製品および役務の内容は以下のとおりであります。

報告セグメント	主要な製品および役務の内容
半導体関連材料	半導体封止用エポキシ樹脂成形材料、感光性ウエハーコート用液状樹脂、半導体用液状樹脂、半導体基板材料
高機能プラスチック	フェノール樹脂成形材料、工業用フェノール樹脂、成形品、合成樹脂接着剤、フェノール樹脂銅張積層板、エポキシ樹脂銅張積層板、航空機内装部品
クオリティオブライフ関連製品	医療機器製品、メラミン樹脂化粧板・化粧シート、ビニル樹脂シートおよび複合シート、鮮度保持フィルム、ポリカーボネート樹脂板、塩化ビニル樹脂板、防水工事の設計ならびに施工請負、バイオ製品